



2021年11月12日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス  
 代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢  
 ( J A S D A Q : コード 6 8 9 0 )  
 問 合 せ 先 IR室 IR・広報部 部長代理 内 田 晋  
 ( 0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6 )

**(開示事項の経過) 当社中国持分法適用会社に対する訴訟及び反訴の経過に関するお知らせ**

2019年12月27日付開示「当社中国子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」にて開示しました杭州中欣晶圆半导体股份有限公司(以下「CCMC」と言います。)に対する中建一局集团建設發展有限公司(以下「中建一局」と言います。)からの訴訟、及び2020年5月15日付「当社中国子会社による訴訟の提起(反訴)に関するお知らせ」にて開示しました中建一局に対するCCMCの反訴につきまして、その後の経過について、下記のとおりお知らせいたします。

なお、CCMCは、2021年2月10日付開示「半導体ウエーハ事業子会社の特定子会社の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり当社の持分法適用会社となり、略称もFTHWからCCMCに変更しております。

記

1. 本件訴訟の相手方の概要

(1) 名 称	中建一局集团建設發展有限公司 (中建一局)
(2) 所 在 地	中華人民共和国北京市朝阳区望花路西里17号楼
(3) 代表者の役職・氏名	法定代表人 廖鋼林

2. 当社持分法適用会社の概要

(1) 名 称	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 (CCMC)
(2) 所 在 地	中国浙江省杭州大江東産業集聚区東晷路3889号709-18
(3) 代表者の役職・氏名	法定代表人 賀 賢 漢
(4) 事 業 内 容	半導体ウエーハの製造
(5) 資 本 金	5,032百万人民币(約855.4億円)(2021年9月30日現在)
(6) 当 社 出 資 比 率	23.05%(2021年9月30日現在)

3. 訴訟の経過

当社の持分法適用関連会社であるCCMCは、中建一局から2019年11月6日付(訴状送達日は2019年12月19日)で、半導体ウエーハ工場建設工事の追加・変更工事代金等総額3億86百万元(約66億5百万元)

についての支払いを求める訴訟を浙江省杭州市中級人民法院に提起されました(以下、「本件提訴」といいます)。同訴訟は、裁判所の裁定を受け、土木工事契約と電気設備工事契約にそれぞれ基づく代金等支払請求の2つの訴訟に分けて再提訴されています。当第2四半期連結会計期間末時点での請求金額の合計額は3億80百萬元(訳65億8百萬元)です。

これに対し、CCMCは、中建一局に対して、2020年4月16日付で、工場建設工事遅延に伴う工事請負契約に基づく違約金、未完成工事の他業者への工事代金等として1億88百萬元(約32億27百萬元)の損害賠償請求を浙江省杭州市中級人民法院に提起しました(前記の中建一局による再提訴に伴い、CCMCも土木工事契約と電気設備工事契約にそれぞれ基づく損害賠償請求の2つの訴訟に分けて再提訴しています)。

また、中建一局は、本件提訴と併せて、CCMCの財産に対し仮差押えを申請し、裁判所から2019年12月18日付で財産保全事項通知書がCCMCに送達され、CCMCの工場の土地使用权等の仮差押えの保全措置がとられておりましたが、土地使用权については2020年4月8日付で、当社の連結子会社である杭州大和熱磁電子有限公司の工場におけるCCMCの土地使用权に仮差押え対象が変更されました。上記再提訴に伴い、中建一局は、改めて、CCMCの財産に対し仮差押えを再申請し、現在手続き中となっております。

上記の再提訴に係る訴訟はいずれも、現在、係争中です。

## 5. 今後の見通し

CCMCは、当第2四半期連結会計期間末時点のこれらの訴訟に関する債務を合理的に見積り、同社の財務諸表に計上しております。今後、これらの訴訟について、同社側の正当性を主張してまいります。本件が、当社の2022年3月期以降の業績に与える影響は軽微と考えられますが、今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上